

檔 號：  
保存年限：

## 台北市電腦商業同業公會 函

地址：105 台北市松山區八德路三段 2  
號 3 樓

聯絡人：吳昱葶

電話：(02) 2577-4249 分機 312

傳真：(02) 2578-6410

電子郵件：annett@mail.tca.org.tw

受文者：德明財經科技大學

發文日期：中華民國112年5月24日

發文字號：電會字第1120002779號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：活動宣傳簡報 (0002779\_att23976.pdf)

主旨：有關「2023 台灣創新技術博覽會-未來科技館」辦理之國際區徵件自即日起受理，請查照並協助推廣報名。

說明：

一、由國科會、中研院、教育部、衛福部共同籌備的未來科技館，將於 112 年 10 月 12 日至 10 月 14 日於台灣創新技術博覽會展出，為促進國際與產學研的合作，特於未來科技館中設置國際區邀請海外機構參展。有鑑於貴校在學術研究領域的國際產學合作成果，邀請貴校符合條件的團隊報名參加。

二、惠請協助所轄網站刊登活動資訊，相關宣傳文件請詳附件（下載連結：<https://reurl.cc/Eo8A0R>），徵件說明如下：

（一）報名資格：

1、國際學研機構（可與校內合作單位聯合參展）

2、外商（包含在台設立的子公司/分公司、代理商）

（二）報名主題：包含但不限於半導體應用與供應鏈、AI，

AIoT 與智慧製造、淨零排放與永續綠能、智慧醫療與精準健康等可應用於產業之創新技術。

(三)報名方式：團隊須於台灣時間 6 月 30 日前回寄申請表  
(下載連結：<https://reurl.cc/94zD8Y>)至未來科技館推動辦公室(annett@mail.tca.org.tw)。

(四)參展資源：

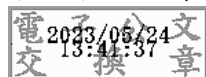
- 1、獲選團隊免參展費
- 2、提供實體與線上攤位
- 3、安排專屬導覽
- 4、媒體廣宣資源

三、如有相關疑問請洽承辦單位(電腦公會)聯絡窗口：未來科技館推動辦公室吳昱葶小姐(連絡電話：02-25774249 轉 312；電子郵件信箱：annett@mail.tca.org.tw)

四、隨函檢附本活動宣傳簡報，惠請協助公告。

正本：各公私立大專院校

副本：



台北市電腦商業同業公會